

半导体 Ptfе 晶圆载具 8英寸 湿法清洗 耐Hf 蚀刻花篮

货号: PL-CP82



简介

这款优质 PTFE 8英寸晶圆载具专为高纯度湿法清洗和 HF

蚀刻应用而设计，旨在优化半导体工艺。我们的工业级氟聚合物花篮确保了最大的耐化学性、卓越的耐用性，并为敏感的洁净室生产环境提供精确的操控。

[了解更多](#)

应用	描述	主要优势
硅晶圆蚀刻	在使用基于 HF 的化学试剂去除牺牲层期间操控晶圆。	完全耐酸侵蚀确保载具的长寿命。
RCA 清洗工艺	在有机和离子污染物去除的多个阶段支撑晶圆。	材料纯度防止已清洁表面的再污染。
CMP 后清洗	在平面化后通过清洗刷和化学浴传输晶圆。	低颗粒脱落保持极低的缺陷计数。
光刻胶剥离	在光刻后使用强效溶剂去除感光涂层。	化学惰性防止材料在溶剂浴中降解。
太阳能电池制造	在高酸环境中支撑光伏电池的大规模基板处理。	大批量生产中的耐用性降低了更换成本。
MEMS 制造	在复杂的湿法释放步骤期间管理精密的机电系统。	精确的槽口对齐可防止对结构的机械损坏。
分析采样	使用载具作为高纯度痕量金属分析的基板支架。	超低背景水平确保准确的实验室结果。

特性类别	PL-CP82 技术详情
产品识别	PL-CP82 系列定制晶圆载具
主要材料	高纯度原生态 PTFE (聚四氟乙烯)
晶圆尺寸兼容性	标准 8英寸 (200mm) / 完全可定制直径
配置类型	单片 (单独) 或多槽可选
制造方法	100% 精密 CNC 加工 (无模制残留物)
温度范围	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
化学兼容性	通用 (HF、HCl、H2SO4、KOH、丙酮等)
表面粗糙度	根据特定洁净室要求可定制
槽距 / 深度	根据客户特定的工艺参数量身定制
手柄/接口	定制机器人拾取点或手动握把选项
尺寸精度	符合工业标准的高精度公差控制